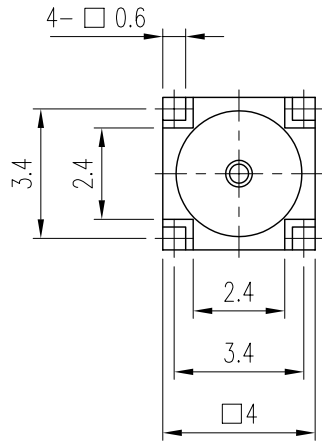
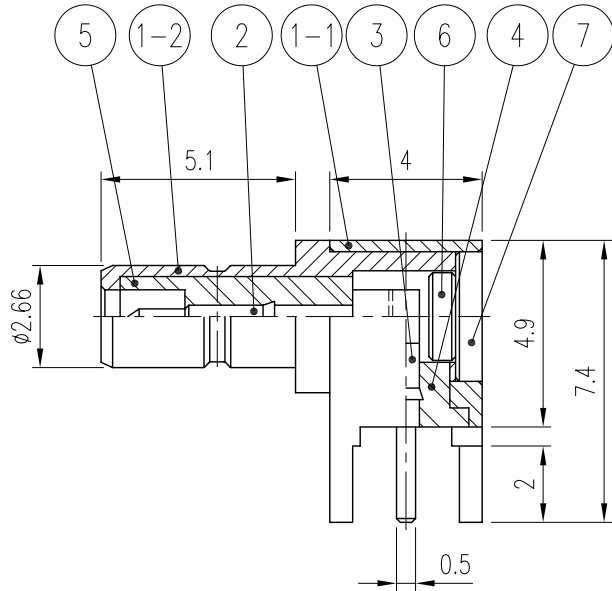


기 종 ST										수 정 내 용				
									부 호	내 용	수 정 자	승 인 자	년 월 일	
ST(기준)									△					
ST(개선)									△					



조립 순서

1. BODY(A)와 (B)를 억지끼움 한다.
2. 각 BODY에 도면과 맞는 INSULATOR를 끼운다.
3. 도면을 참조하여 INSULATOR를 끼운 BODY에 PIN을 조립한다.
4. 두개의 PIN이 겹쳐지는 부위에 땀을 한다.
5. COVER INSULATOR를 넣고, COVER를 박는다.

7	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00008-5/1 (LE002)	
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00927-N/1 (H1516)	
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00266-N/1 (HE008)	
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00267-N/1 (HE007)	
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00325-5/1 (EE007)	
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00329-5/1 (EE006)	
1	1-2 BODY (B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00223-5/1	DBD00378-3/1
	1-1 사각 BODY (A)	1	MBsBD	Gold Plate		DBD00379-3/1

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 소수 각도 분수 ±0.1	년월일 2005. 7. 4.	RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017				
재질	승인					
열처리	검도					
보호피막처리	제도	도명			SSMB-LJ-4R-R	
	작성부서	연 구 소			A4	VER.0
	적도 NS	단위 mm	총량	도번		CN00881-7/1
						K355-601-000